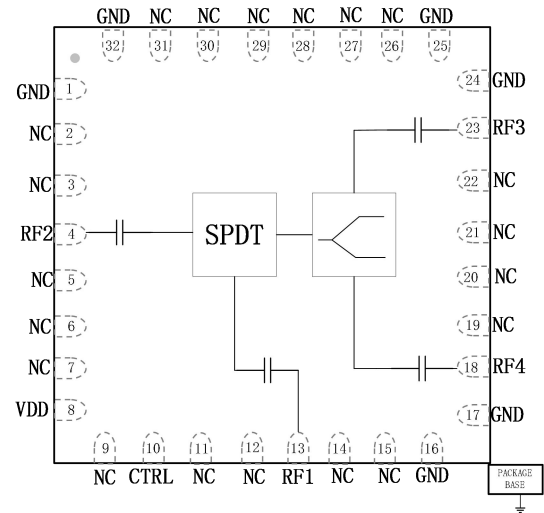


主要特点

全正电控制，集成TTL
工作频率：0.35 – 2 GHz
插入损耗：5.0 dB
通道隔离度：60 dB
供电：+5 V @ 2 mA
输入/输出：50 Ohm 匹配
陶封尺寸：32 Lead，5mm × 5 mm QFN

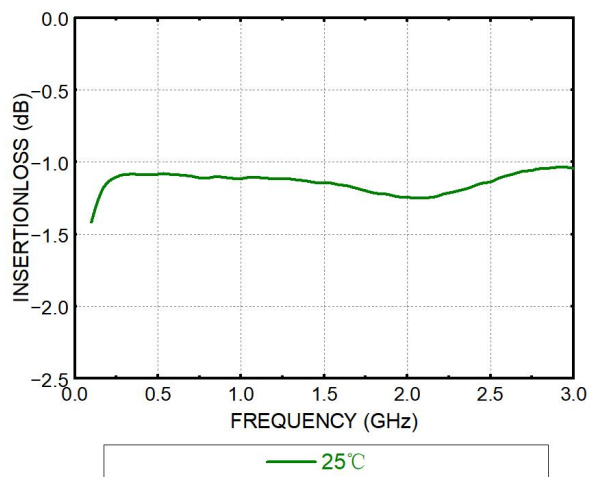
功能框图



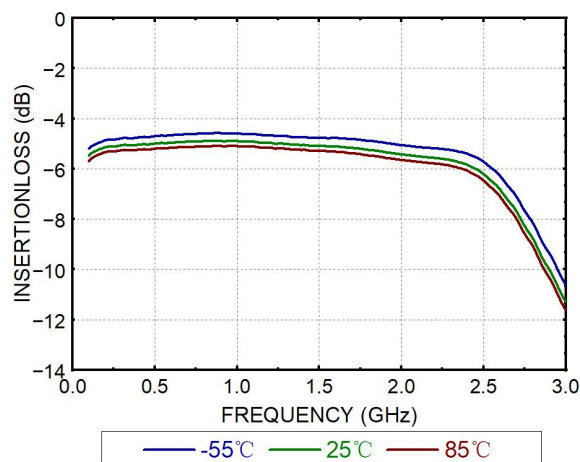
性能指标 ($T_A = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = +5\text{ V}$, $CTRL=0/+5V$, $P_{in}=-25\text{ dBm}$)

参数	最小	典型	最大	单位	备注
频率范围		0.35 – 2		GHz	
插入损耗		1.0	1.6	dB	RF1-RF2
		5.0	6		RF1-RF3/RF4
带内平坦度		0.6	1.0	dB	
输入驻波		1.5	2		
输出驻波		1.5	2		
通道隔离度	55	60		dB	RF2-RF3/RF4
幅度一致性		± 0.5		dB	RF1-RF3/RF4
相位一致性		± 3		°	
同批次幅度一致性		± 0.5		dB	
同批次相位一致性		± 3		°	
开关切换时间		25		ns	
电源电压	4.75	5	5.25	V	
工作电流		2		mA	

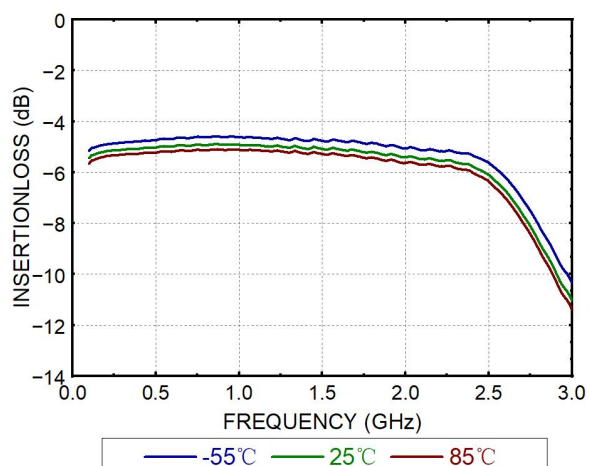
RF1-RF2支路插损



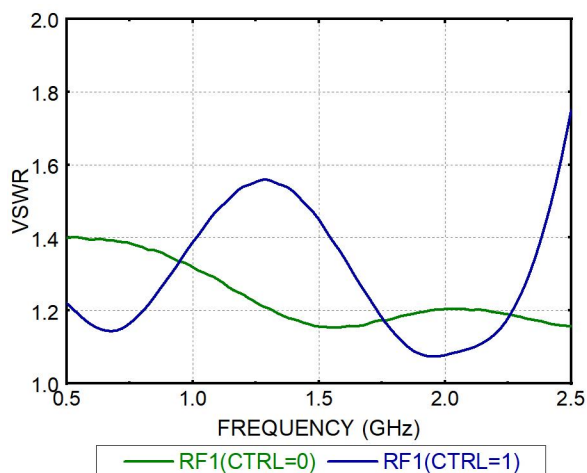
RF1-RF3支路插损 vs. 温度



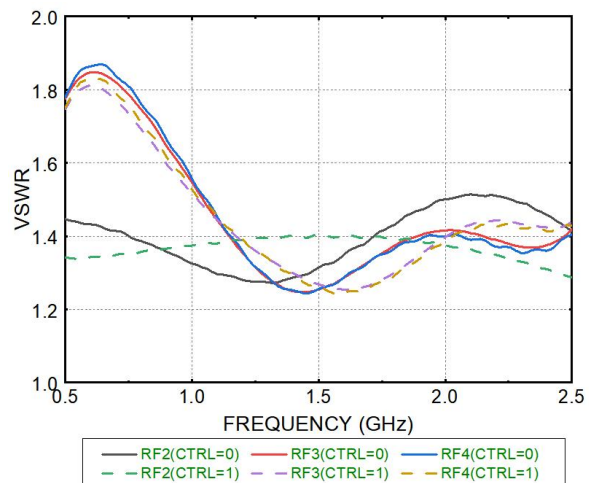
RF1-RF4支路插损 vs. 温度



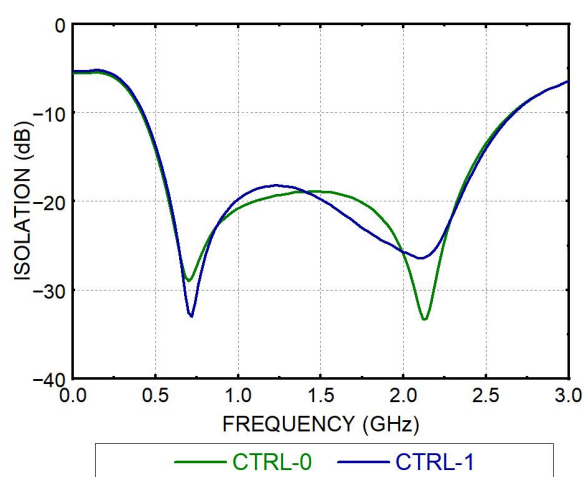
输入驻波



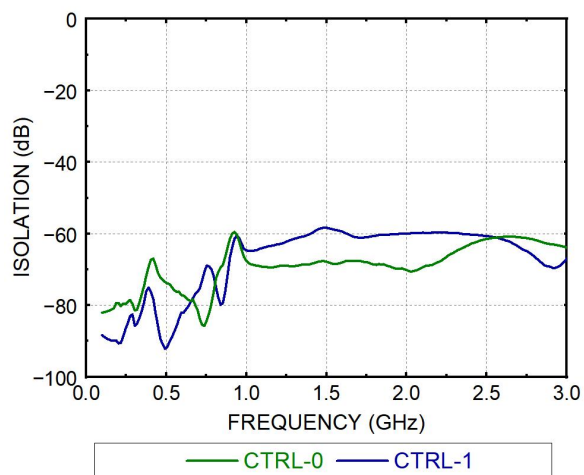
输出驻波



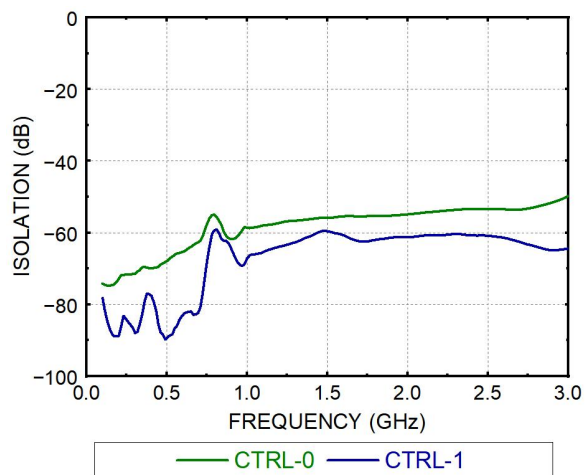
RF3-RF4支路隔离度



RF2-RF3支路隔离度

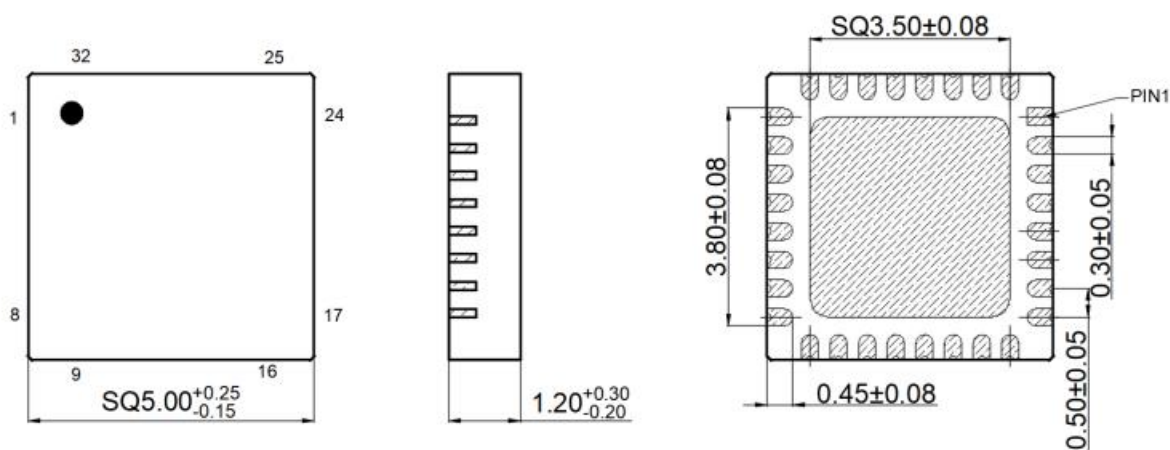


RF2-RF4支路隔离度



物理参数

单位: mm



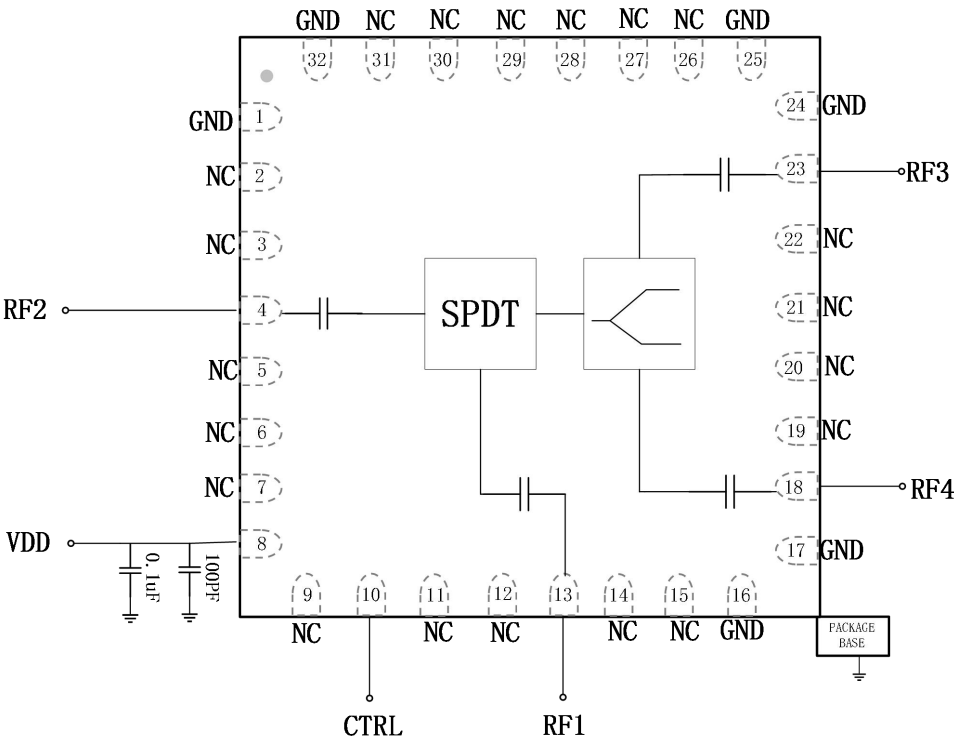
注意事项:

1. 器件在干燥、氮气环境中存储;
2. 器件对静电敏感, 在储存、运输、储存、装配和使用过程中注意防静电;
3. 所有接地引脚请连接 RF/DC 地;
4. 该产品适用于回流焊贴装工艺, 回流焊温度 $\leq 265^{\circ}\text{C}$, 陶封产品回流焊使用时需要做去金预处理。

引脚描述

引脚序号	功能	描述
4	RF2	该引脚是射频端口，AC 耦合，并匹配至 50Ohm，无需外接隔直电容
13	RF1	该引脚是射频端口，AC 耦合，并匹配至 50Ohm，无需外接隔直电容
18	RF4	该引脚是射频端口，AC 耦合，并匹配至 50Ohm，无需外接隔直电容
23	RF3	该引脚是射频端口，AC 耦合，并匹配至 50Ohm，无需外接隔直电容
8	VDD	该引脚是数字电路电源端，接+5V 电源电压
10	CTRL	该引脚是开关控制端口
其余	NC	接地或者悬空
1,16,17,24,25,32	GND	该引脚是接地端，必须连接至 RF/DC 地
底部中央焊盘	GND	底部中央焊盘必须连接至 RF/DC 地

推荐装配图



真值表

功能	CTRL
RF1-RF3/RF4	1
RF1-RF2	0
“0”电平范围：0-0.8V，“1”电平范围：2.3-5V。	

极限参数

1. 电源电压：+5.5 V
2. 射频输入功率：+25 dBm
3. 储存温度：-55 ~ +125℃
4. 工作温度：-55 ~ +85 ℃